

2017-2022年中国PCB行业市场运营态势及发展前景预测报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国PCB行业市场运营态势及发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201612/477562.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

PCB (Printed Circuit Board) ，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。印制电路板的创造者是奥地利人保罗·爱斯勒 (Paul Eisler) ，1936年，他首先在收音机里采用了印刷电路板。1943年，美国人多将该技术运用于军用收音机，1948年，美国正式认可此发明可用于商业用途。自20世纪50年代中期起，印刷线路板才开始被广泛运用。

PCB生产企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、北美及欧洲等六大区域。全球印制线路板行业比较分散，生产商众多，尚未出现市场主导者。我国外资企业数量只占到我国PCB企业数量的10%，但是产值占到我国PCB行业的三分之二。我国企业产品集中在中低端，行业企业没有几个国际知名品牌。我国现虽然从产业规模来看已经是全球第一，但从PCB产业总体的技术水平来讲，仍然落后于世界先进水平。在产品结构上，多层板占据了大部分产值比例，但大部分为8层以下的中低端产品，HDI、挠性板等有一定的规模但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距，技术含量最高的IC载板在国内更是很少有企业能够生产。过去十年来，全球PCB持续向亚洲尤其是中国大陆迁移，中国大陆迅速成为电子产品和PCB生产大国。中国因内需市场潜力与生产制造优势，吸引外资纷纷进驻，促使中国大陆PCB产业在短短数年内以倍数成长，

2015年国内PCB行业企业数量在1500家以上，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域。长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右；中西部地区PCB产能近年来也扩张较快。

PCB 产业链构成

从 20 世纪 40 年代开始，PCB 已经成为 电子行业中最重要子行业之一。近年来全球 PCB 产业产值占电子元件产业总产值的 1/4 以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业。 2012 年至 2017 年期间，全球 PCB 将保持 3.9%的年复合增长率稳定增长，预计 2017 年整体规模将有望达到 642 亿美元。

2009-2022 全球 PCB 行业产值统计及预测

智研咨询发布的《2017-2022年中国PCB行业市场运营态势及发展前景预测报告》共十四章。首先介绍了PCB相关概念及发展环境，接着分析了中国PCB规模及消费需求，然后对中国PCB市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国PCB面临的机遇及发展前景。您若想对中国PCB有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 PCB行业相关概述

1.1 PCB的相关概念

1.1.1 PCB的定义

1.1.2 PCB的作用

1.1.3 PCB的分类

1、单面板

2、双面板

3、多层板

1.2 PCB的生产及应用

1.2.1 PCB的生产流程

1.2.2 PCB的软硬分类

1.2.3 PCB的构成

1.2.4 PCB的特点

1.3 PCB的设计流程

1.3.1 网表输入

1.3.2 规则设置

1.3.3 元器件布局

1.3.4 布线

1.3.5 检查

1.3.6 复查

1.3.7 输出

1.4 PCB行业产业链分析

第二章 PCB行业市场特点概述

2.1 行业市场概况

2.1.1 PCB行业发展迅猛

2.1.2 区域分布不均衡

2.1.3 PCB下游应用分布广泛

2.2 PCB产业特点

2.2.1 电路板属订单型生产形态

2.2.2 电路板的制造流程长且复杂

2.2.3 电路板产业属资本密集型行业

2.2.4 电路板产业的议价能力相对较弱

2.3 PCB行业的周期性及区域性分析

2.3.1 PCB用途广泛生命力强大

2.3.2 PCB产业在各区域的分布分析

2.4 PCB行业发展概述

2.4.1 PCB行业发展简史

2.4.2 PCB行业发展特点

2.4.3 PCB行业发展总体分析

第三章 2014-2016年中国PCB行业发展环境分析

3.1 PCB行业政治法律环境

3.1.1 行业相关政策

3.1.2 PCB行业国内标准

3.1.3 PCB行业国际标准

3.1.4 相关产业政策分析

3.1.5 行业相关发展规划

3.2 PCB行业经济环境分析

3.2.1 国民经济运行情况与GDP

2016年上半年国内生产总值34.06万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%。分产业看，第一产业增加值22097亿元，同比增长3.1%；第二产业增加值134250亿元，增长6.1%；第三产业增加值184290亿元，增长7.5%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。

2008- 2016年上半年中国GDP增长趋势分析（单位：亿元，%）

3.2.2 消费价格指数CPI、PPI

3.2.3 固定资产投资情况

3.2.4 全国居民收入情况

3.3 PCB行业社会环境分析

3.3.1 PCB产业的环保问题分析

3.3.2 解决PBC企业污染问题的相关措施

3.4 PCB行业技术环境分析

3.4.1 我国PCB技术落后于世界先进水平

3.4.2 PCB生产中的常见问题

3.4.3 技术环境对行业的影响

第四章 全球PCB行业发展概述

4.1 2014-2016年全球PCB行业发展情况概述

4.1.1 全球PCB产值比重大

4.1.2 全球PCB行业发展特征

4.1.3 全球PCB行业市场规模

4.2 2014-2016年全球主要地区PCB行业发展状况

4.2.1 台湾PCB行业发展情况概述

1、台湾PCB市场总体分析

2、台湾PCB产业之市场分析

3、台湾PCB之产业群聚与结构

4、台湾PCB产业之竞争力分析

4.2.2 北美PCB行业发展情况概述

4.2.3 日本PCB行业发展情况概述

4.2.4 韩国PCB行业发展情况概述

4.3 2017-2022年全球PCB行业发展前景预测

4.3.1 全球PCB行业市场规模预测

4.3.2 全球PCB行业发展前景分析

4.3.3 全球PCB行业发展趋势分析

4.4 全球PCB行业重点企业发展动态分析

第五章 中国PCB行业发展概述

5.1 中国PCB行业发展状况分析

5.1.1 中国PCB行业发展阶段

5.1.2 中国PCB行业发展总体概况

5.1.3 中国PCB行业发展特点分析

5.2 2014-2016年PCB行业发展现状

5.2.1 2014-2016年中国PCB行业市场规模

5.2.2 2014-2016年中国PCB行业发展分析

5.2.3 2014-2016年中国PCB企业发展分析

5.3 2017-2022年中国PCB行业面临的问题及对策

5.3.1 中国PCB行业面临的问题

1、美国重塑制造业影响中国制造业

2、PCB设备仪器企业发展不够快

3、PCB原辅料企业还很弱小

4、从事PCB环保的企业缺乏特色

5.3.2 中国PCB企业发展困境及策略分析

1、中国PCB企业面临的困境

2、中国PCB企业的对策探讨

5.3.3 国内PCB企业的出路分析

第六章 中国PCB行业上游原材料市场分析

6.1 铜箔

6.1.1 铜箔的相关概述

6.1.2 铜箔的全球供应状况

6.1.3 铜箔在柔性PCB中的应用

6.1.4 电解铜箔产业的发展分析

6.2 环氧树脂

6.2.1 环氧树脂的相关概述

6.2.2 环氧树脂的应用领域

6.2.3 中国环氧树脂产业的市场前景

6.2.4 2016年环氧树脂市场走势分析

6.2.5 PCB用环氧树脂发展趋势

6.3 玻璃纤维

6.3.1 玻璃纤维的相关概述

6.3.2 中国玻璃纤维面临巨大市场需求

6.3.3 2016年中国玻璃纤维行业经济运行情况

6.3.4 2016年中国玻璃纤维产业的发展分析

第七章 PCB制造技术研究

7.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

7.1.1 PCB芯片封装的介绍

7.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法

7.1.3 PCB芯片封装的流程

7.2 光电PCB技术

7.2.1 光电PCB的概述

7.2.2 光电PCB的光互连结构原理

7.2.3 光学PCB的优点

7.2.4 光电PCB的发展阶段

7.3 PCB抄板

7.3.1 PCB抄板简介

7.3.2 PCB抄板技术流程

7.3.3 PCB抄板技术价值分析

7.3.4 PCB抄板发展趋势

7.4 PCB技术的发展趋势

7.4.1 沿着高密度互连技术（HDI）道路发展下去

7.4.2 组件埋嵌技术具有强大的生命力

7.4.3 PCB中材料开发要更上一层楼

7.4.4 光电PCB前景广阔

7.4.5 制造工艺要更新、先进设备要引入

第八章 中国PCB行业下游应用领域分析

8.1 汽车电子

8.1.1 PCB成为汽车电子市场的热点

8.1.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

8.1.3 2015年全球汽车电子PCB市场发展分析

8.2 通讯设备

8.2.1 2015年中国通讯设备制造业发展情况

8.2.2 未来移动通信设备的趋势

8.2.3 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

8.3 消费类电子产品

8.3.1 2016年中国消费电子产品走向高端

8.3.2 消费电子用PCB的市场需求稳定增长

8.3.3 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

8.3.4 消费电子行业未来发展市场调查分析

8.4 LED照明

8.4.1 2015年中国LED照明的发展状况

8.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

8.5 电脑及相关产品发展分析

8.5.1 2016年电脑及相关产品市场情况

8.5.2 2016年国内电脑市场需求分析预测

8.6 工业及医疗电子市场发展分析

8.6.1 2016年工业电子市场发展分析

8.6.2 2016年医疗电子市场发展分析

8.6.3 2016年医疗电子市场机遇分析

第九章 中国PCB行业市场竞争格局分析

9.1 中国PCB行业竞争格局分析

9.1.1 PCB行业区域分布格局

9.1.2 PCB行业企业规模格局

9.1.3 PCB行业企业性质格局

9.2 中国PCB行业竞争五力分析

9.2.1 PCB行业上游议价能力

9.2.2 PCB行业下游议价能力

9.2.3 PCB行业新进入者威胁

9.2.4 PCB行业替代产品威胁

9.2.5 PCB行业现有企业竞争

9.3 中国PCB行业竞争SWOT分析

9.3.1 PCB行业优势分析

9.3.2 PCB行业劣势分析

9.3.3 PCB行业机会分析

9.3.4 PCB行业威胁分析

9.4 中国PCB行业投资兼并重组整合分析

9.4.1 投资兼并重组现状

9.4.2 投资兼并重组案例

9.5 中国PCB行业重点企业竞争策略分析

第十章 中国PCB行业领先企业竞争力分析

10.1 臻鼎科技控股股份有限公司

10.1.1 企业发展基本情况

10.1.2 企业主要产品分析

10.1.3 企业竞争优势分析

10.1.4 企业经营状况分析

10.1.5 企业最新发展动态

10.1.6 企业发展战略分析

10.2 健鼎科技股份有限公司

10.2.1 企业发展基本情况

10.2.2 企业主要产品分析

10.2.3 企业竞争优势分析

10.2.4 企业经营状况分析

10.2.5 企业最新发展动态

- 10.2.6 企业发展战略分析
- 10.3 欣兴电子股份有限公司
 - 10.3.1 企业发展基本情况
 - 10.3.2 企业主要产品分析
 - 10.3.3 企业竞争优势分析
 - 10.3.4 企业经营状况分析
 - 10.3.5 企业最新发展动态
 - 10.3.6 企业发展战略分析
- 10.4 迅达科技亚太区
 - 10.4.1 企业发展基本情况
 - 10.4.2 企业主要产品分析
 - 10.4.3 企业竞争优势分析
 - 10.4.4 企业经营状况分析
 - 10.4.5 企业最新发展动态
 - 10.4.6 企业发展战略分析
- 10.5 珠海紫翔电子科技有限公司
 - 10.5.1 企业发展基本情况
 - 10.5.2 企业主要产品分析
 - 10.5.3 企业竞争优势分析
 - 10.5.4 企业经营状况分析
 - 10.5.5 企业最新发展动态
 - 10.5.6 企业发展战略分析
- 10.6 惠亚集团
 - 10.6.1 企业发展基本情况
 - 10.6.2 企业主要产品分析
 - 10.6.3 企业竞争优势分析
 - 10.6.4 企业经营状况分析
 - 10.6.5 企业最新发展动态
 - 10.6.6 企业发展战略分析
- 10.7 维讯柔性电路板（苏州）有限公司
 - 10.7.1 企业发展基本情况
 - 10.7.2 企业主要产品分析
 - 10.7.3 企业竞争优势分析
 - 10.7.4 企业经营状况分析
 - 10.7.5 企业最新发展动态

10.7.6 企业发展战略分析

10.8 志超科技股份有限公司

10.8.1 企业发展基本情况

10.8.2 企业主要产品分析

10.8.3 企业竞争优势分析

10.8.4 企业经营状况分析

10.8.5 企业最新发展动态

10.8.6 企业发展战略分析

10.9 名幸电子有限公司

10.9.1 企业发展基本情况

10.9.2 企业主要产品分析

10.9.3 企业竞争优势分析

10.9.4 企业经营状况分析

10.9.5 企业最新发展动态

10.9.6 企业发展战略分析

10.10 深南电路股份有限公司

10.10.1 企业发展基本情况

10.10.2 企业主要产品分析

10.10.3 企业竞争优势分析

10.10.4 企业经营状况分析

10.10.5 企业最新发展动态

10.10.6 企业发展战略分析

第十一章 2017-2022年中国PCB行业发展趋势与前景分析

11.1 2017-2022年中国PCB市场发展前景

11.1.1 2017-2022年PCB市场发展潜力

11.1.2 2017-2022年PCB市场发展前景展望

11.1.3 2017-2022年PCB细分行业发展前景分析

11.2 2017-2022年中国PCB市场发展趋势预测

11.2.1 2017-2022年PCB行业发展趋势

11.2.2 2017-2022年PCB市场规模预测

11.2.3 2017-2022年PCB行业应用趋势预测

11.2.4 2017-2022年细分市场发展趋势预测

11.3 2017-2022年中国PCB行业供需预测

11.3.1 2017-2022年中国PCB行业供给预测

11.3.2 2017-2022年中国PCB行业需求预测

11.3.3 2017-2022年中国PCB供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 行业发展有利因素与不利因素

11.4.2 市场整合成长趋势

11.4.3 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.4 企业区域市场拓展的趋势

11.4.5 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.6 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2017-2022年中国PCB行业投资前景

12.1 PCB行业投资现状分析

12.1.1 PCB行业投资规模分析

12.1.2 PCB行业投资资金来源构成

12.1.3 PCB行业投资项目建设分析

12.1.4 PCB行业投资资金用途分析

12.1.5 PCB行业投资主体构成分析

12.2 PCB行业投资特性分析

12.2.1 PCB行业进入壁垒分析

12.2.2 PCB行业盈利模式分析

12.2.3 PCB行业盈利因素分析

12.3 PCB行业投资机会分析

12.3.1 产业链投资机会

12.3.2 细分市场投资机会

12.3.3 重点区域投资机会

12.3.4 产业发展的空白点分析

12.4 PCB行业投资风险分析

12.4.1 PCB行业政策风险

12.4.2 宏观经济风险

12.4.3 市场竞争风险

12.4.4 关联产业风险

12.4.5 产品结构风险

12.4.6 技术研发风险

12.4.7 其他投资风险

12.5 PCB行业投资潜力与建议

- 12.5.1 PCB行业投资潜力分析
- 12.5.2 PCB行业最新投资动态
- 12.5.3 PCB行业投资机会与建议

第十三章 2017-2022年中国PCB企业投资战略与客户策略分析

13.1 PCB企业发展战略规划背景意义

- 13.1.1 企业转型升级的需要
- 13.1.2 企业做大做强的需要
- 13.1.3 企业可持续发展需要

13.2 PCB企业战略规划制定依据

- 13.2.1 国家政策支持
- 13.2.2 行业发展规律
- 13.2.3 企业资源与能力
- 13.2.4 可预期的战略定位

13.3 PCB企业战略规划策略分析

- 13.3.1 战略综合规划
- 13.3.2 技术开发战略
- 13.3.3 区域战略规划
- 13.3.4 产业战略规划
- 13.3.5 营销品牌战略
- 13.3.6 竞争战略规划

13.4 PCB中小企业发展战略研究

13.4.1 中小企业存在主要问题

- 1、缺乏科学的发展战略
- 2、缺乏合理的企业制度
- 3、缺乏现代的企业管理
- 4、缺乏高素质的专业人才
- 5、缺乏充足的资金支撑

13.4.2 中小企业发展战略思考

- 1、实施科学的发展战略
- 2、建立合理的治理结构
- 3、实行严明的企业管理
- 4、培养核心的竞争实力
- 5、构建合作的企业联盟

第十四章 研究结论及建议 (ZY ZM)

14.1 研究结论

14.2 建议

14.2.1 行业发展策略建议

14.2.2 行业投资方向建议

14.2.3 行业投资方式建议

图表目录：

图表：PCB产品实物图

图表：PCB的分类示意图

图表：PCB行业产业链分析

图表：2014-2016年PCB行业市场规模分析

图表：2017-2022年PCB行业市场规模预测

图表：中铜箔分类

图表：压延铜箔的生产过程示意图

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：国际消费电子产品销量走势

图表：主板PCB颜色对消费者的影响

图表：2014-2016年PCB重要数据指标比较

图表：2014-2016年中国PCB行业销售情况分析

图表：2014-2016年中国PCB行业利润情况分析

图表：2014-2016年中国PCB行业资产情况分析

图表：2014-2016年中国PCB竞争力分析

图表：2017-2022年中国PCB消费量预测

图表：2017-2022年中国PCB市场前景预测

图表：2017-2022年中国PCB市场价格走势预测

图表：2017-2022年中国PCB发展前景预测

图表：投资建议

图表：区域发展战略规划

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201612/477562.html>